

SNx4AC14 ヘキサ シュミット トリガ インバータ

1 特長

- 2V~6V の V_{CC} で動作
- 6V までの入力電圧に対応
- 最大 t_{pd} 9.5ns (5V 時)

2 アプリケーション

- 反転クロック入力の同期
- スイッチのデバウンス
- デジタル信号の反転

3 概要

これらのシュミットトリガ デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
SNx4AC14	BQA (WQFN, 14)	3.00mm × 2.50mm	3.00mm × 2.50mm
	D (SOIC, 14)	8.65mm × 6mm	8.65mm × 3.9mm
	DB (SSOP, 14)	6.2mm × 7.8mm	6.2mm × 5.3mm
	N (PDIP, 14)	19.3mm × 9.4mm	19.3mm × 6.35mm
	NS (SOP, 14)	10.2mm × 7.8mm	10.3mm × 5.3mm
	PW (TSSOP, 14)	5mm × 6.4mm	5mm × 4.4mm

- (1) 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図 (正論理)



目次

1 特長	1	7.3 機能説明.....	9
2 アプリケーション	1	7.4 デバイスの機能モード.....	10
3 概要	1	8 アプリケーション情報に関する免責事項	11
4 ピン構成および機能	3	8.1 アプリケーション情報.....	11
5 仕様	5	8.2 代表的なアプリケーション.....	11
5.1 絶対最大定格.....	5	8.3 電源に関する推奨事項.....	13
5.2 ESD 定格.....	5	8.4 レイアウト.....	13
5.3 推奨動作条件.....	5	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	14
5.4 熱に関する情報.....	5	9.1 ドキュメントのサポート.....	14
5.5 電気的特性.....	6	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	14
5.6 スイッチング特性.....	6	9.3 サポート・リソース.....	14
5.7 スイッチング特性.....	7	9.4 商標.....	14
5.8 動作特性.....	7	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	14
6 パラメータ測定情報	8	9.6 用語集.....	14
7 詳細説明	9	10 改訂履歴	14
7.1 概要.....	9	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	15
7.2 機能ブロック図.....	9		

4 ピン構成および機能

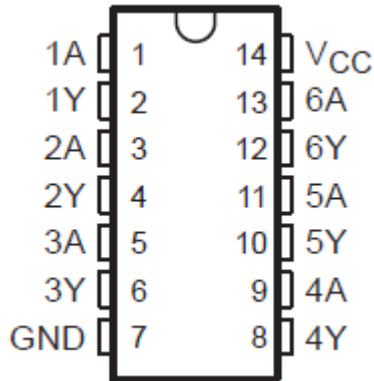


図 4-1. SN54AC14 J または W パッケージ、
SN74AC14 D、DB、N、NS、または PW パッケージ、
14 ピン CDIP、CFP、SSOP、SOIC、PDIP、SOP、ま
たは TSSOP (上面図)

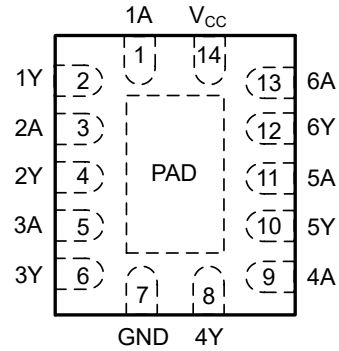
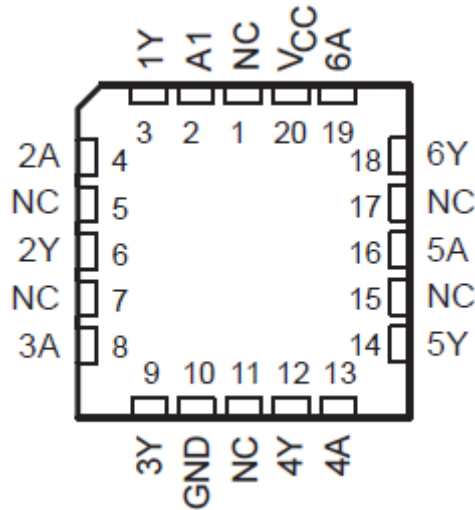


図 4-2. SN54AC14 BQA パッケージ、14 ピン WQFN
(上面図)



NC - 内部接続なし

図 4-3. SN54AC14 FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)

表 4-1. ピンの機能

名称	ピン		I/O	説明
	D、DB、N、 NS、PW、 BQA、J、ま たは W	FK		
1A	1	2	入力	チャンネル 1、入力 A
1Y	2	3	出力	チャンネル 1、出力 Y
2A	3	4	入力	チャンネル 2、入力 A
2Y	4	6	出力	チャンネル 2、出力 Y
3A	5	8	入力	チャンネル 3、入力 A
3Y	6	9	出力	チャンネル 3、出力 Y

表 4-1. ピンの機能 (続き)

名称	ピン		I/O	説明
	D、DB、N、NS、PW、BQA、J、または W	FK		
GND	7	10	—	グラウンド
4Y	8	12	出力	チャンネル 4、出力 Y
4A	9	13	入力	チャンネル 4、入力 A
5Y	10	14	出力	チャンネル 5、出力 Y
5A	11	16	入力	チャンネル 5、入力 A
6Y	12	18	出力	チャンネル 6、出力 Y
6A	13	19	入力	チャンネル 6、入力 A
V _{CC}	14	20	—	正の電源
NC		1、5、7、11、15、17	—	内部接続なし
サーマル パッド ⁽¹⁾			—	サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。

(1) BQA パッケージのみ。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V _{CC}	電源電圧範囲	-0.5V	7	V
V _I ⁽²⁾	入力電圧範囲	-0.5V	V _{CC} + 0.5	V
V _O ⁽²⁾	出力電圧範囲	-0.5V	V _{CC} + 0.5	V
I _{IK}	入力クランプ電流	(V _I < 0 または V _I > V _{CC})	±20	mA
I _{OK}	出力クランプ電流	(V _O < 0 または V _O > V _{CC})	±20	mA
I _O	連続出力電流	(V _O = 0 ~ V _{CC})	±50	mA
	V _{CC} または GND を通過する連続電流		±200	mA
T _{stg}	保管温度範囲	-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはいくまでもストレス評価であり、データシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン ⁽¹⁾	±4000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン ⁽²⁾	±2000	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

5.3 推奨動作条件

		SN54AC14		SN74AC14		単位
		最小値	最大値	最小値	最大値	
V _{CC}	電源電圧	2	6	2	6	V
V _I	入力電圧	0	V _{CC}	0	V _{CC}	V
V _O	出力電圧	0	V _{CC}	0	V _{CC}	V
I _{OH}	High レベル出力電流	V _{CC} = 3 V		-12	-12	mA
		V _{CC} = 4.5 V		-24	-24	
		V _{CC} = 5.5 V		-24	-24	
I _{OL}	Low レベル出力電流	V _{CC} = 3 V		12	12	mA
		V _{CC} = 4.5 V		24	24	
		V _{CC} = 5.5 V		24	24	
T _A	自由空気での動作温度	-55	125	-40	85	°C

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾	熱評価基準 ⁽¹⁾	SN74AC14						単位
		BQA (WQFN)	D (SOIC)	DB (SSOP)	N (PDIP)	NS (SO)	PW (TSSOP)	
		14 ピン						
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	93.4	89.9	96	72.1	92.4	148	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーションレポートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	T _A = 25°C			SN54AC14		SN74AC14		単位
			最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
V _{T+} 正方向 のスレッシュホールド		3 V	0.8	1.8	2.2	0.8	2.2	0.8	2.2	V
		4.5 V	1.5	2.6	3.2	1.5	3.2	1.5	3.2	
		5.5 V	1.6	3.2	3.9	1.6	3.9	1.6	3.9	
V _{T-} 負方向 スレッシュホールド		3 V	0.5	0.8	1	0.5	1.2	0.5	1	V
		4.5 V	0.9	1.4	1.8	0.9	1.8	0.9	1.8	
		5.5 V	1.1	1.8	2.3	1.1	2.3	1.1	2.3	
ΔV _T ヒステリシス (V _{T+} - V _{T-})		3 V	0.3	1	1.2	0.3	1.2	0.3	1.2	V
		4.5 V	0.4	1.2	1.4	0.4	1.4	0.4	1.4	
		5.5 V	0.5	1.4	1.6	0.5	1.6	0.5	1.6	
V _{OH}	I _{OH} = -50μA	3 V	2.9			2.9		2.9		V
		4.5 V	4.4			4.4		4.4		
		5.5 V	5.4			5.4		5.4		
	I _{OH} = -12 mA	3 V	2.56			2.4		2.48		
		4.5 V	3.86			3.7		3.8		
	I _{OH} = -24 mA	4.5 V	3.86			4.7		4.8		
		5.5 V	4.86			4.7		4.8		
I _{OH} = -50 mA ⁽¹⁾	5.5 V				3.85					
I _{OH} = -75mA ⁽¹⁾	5.5 V						3.85			
V _{OL}	I _{OL} = 50μA	3 V	0.1			0.1		0.1		V
		4.5 V	0.1			0.1		0.1		
		5.5 V	0.1			0.1		0.1		
	I _{OL} = 12 mA	3 V	0.36			0.44		0.44		
		4.5 V	0.36			0.44		0.44		
	I _{OL} = 24 mA	4.5 V	0.36			0.44		0.44		
		5.5 V	0.36			0.44		0.44		
I _{OL} = 50mA ⁽¹⁾	5.5 V				1.65					
I _{OL} = 75 mA ⁽¹⁾	5.5 V						1.65			
I _I	V _I = V _{CC} または GND	5.5 V	±0.1			±1		±1		μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} または GND、 I _O = 0	5.5 V	2			40		20		μA
C _i	V _I = V _{CC} または GND	5 V	4.5							pF

(1) 一度に複数の出力をテストすることはできません。また、テスト期間は 10 ms を超えないようにしてください。

5.6 スイッチング特性

自由気流での推奨動作温度範囲内、V_{CC} = 3.3V±0.3V (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	T _A = 25°C			SN54AC14		SN74AC14		単位
			最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t _{PLH}	A	Y	1.5	6	13.5	1	16	1.5	15	ns
t _{PHL}			1.5	6	11.5	1	14	1.5	13	

5.7 スイッチング特性

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $V_{CC} = 5 V \pm 0.5 V$ (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54AC14		SN74AC14		単位
			最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t_{PLH}	A	Y	1.5	5	10	1.5	12	1.5	11	ns
t_{PHL}			1.5	5	8.5	1.5	10	1.5	9.5	

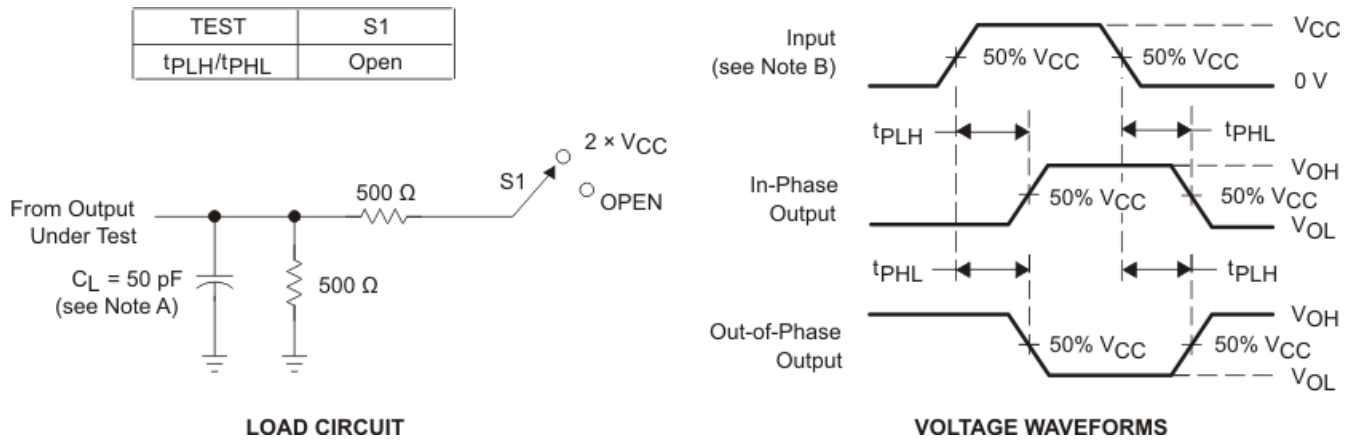
5.8 動作特性

$V_{CC} = 5V$ 、 $T_A = 25^\circ\text{C}$

パラメータ		テスト条件	代表値	単位
C_{pd}	電力散逸容量	$C_L = 50\text{pF}$ 、 $f = 1\text{MHz}$	25	pF

6 パラメータ測定情報

6.1



- A. C_L にはプローブと治具の容量が含まれます。
- B. すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR \leq 1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_r \leq 2.5$ ns、 $t_f \leq 2.5$ ns。
- C. 出力は一度に1つずつ測定され、測定するたびに入力が1回遷移します。

図 6-1. 負荷回路および電圧波形

7 詳細説明

7.1 概要

これらの AC14 デバイスは、ブール関数 $Y = \bar{A}$ を実行します。シュミット アクションにより、正方向 (V_{T+}) および負方向 (V_{T-}) の信号に対して異なる入力スレッショルドレベルを設定できます。

これらの回路は温度補償されており、最も遅い入力ランプからトリガできますが、クリーンなジッタのない出力信号を出力できます。また、従来型インバータに比べてノイズマージンが大きくなります。

7.2 機能ブロック図



7.3 機能説明

- V_{CC} は 5V に最適化
- 3.3V~5V の昇圧変換を許可
 - 入力は 2V の V_{IH} レベルに対応
- 低エッジレートにより出力リングングを最小化
- 入力は TTL 電圧互換

7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

7.3.2 クランプダイオード構造

図 7-1 に示すように、このデバイスの入力と出力には正と負の両方のクランプダイオードがあります。

注意

絶対最大定格の表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

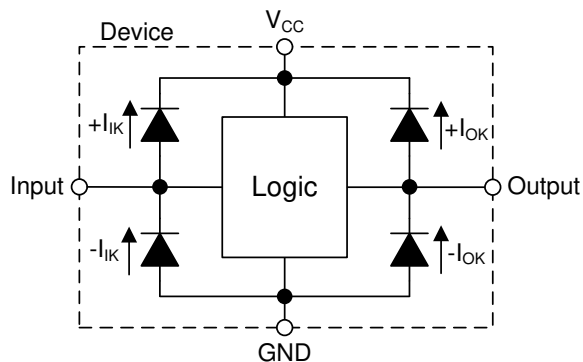


図 7-1. 各入力と出力に対するクランプダイオードの電氣的配置

7.4 デバイスの機能モード

表 7-1. 機能表

入力	出力
A	Y
H	L
L	H

8 アプリケーション情報に関する免責事項

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

SNx4AC14 デバイスは、出力リンギングが懸念される多くのバス インターフェイス タイプのアプリケーションで使用できる低駆動能力の CMOS デバイスです。低駆動および低速エッジレートにより、出力のオーバーシュートとアンダーシュートが最小限に抑えられます。入力は、任意の有効な V_{CC} において 5.5V 耐圧です。この機能により、 V_{CC} レベルへの変換に理想的です。「スイッチング特性の比較」に、AC などのより高い駆動部品と比較してリンギングが減少していることを示します。

8.2 代表的なアプリケーション

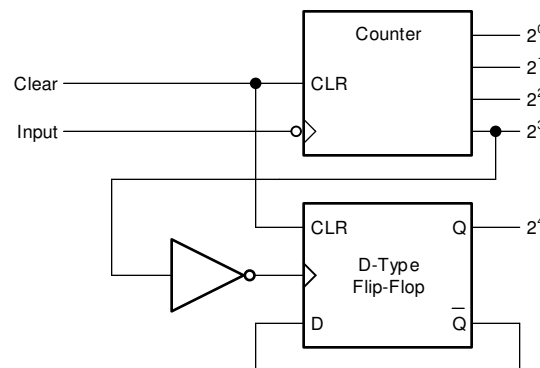


図 8-1. 代表的なアプリケーション回路図

8.2.1 設計要件

このデバイスは CMOS 技術を採用しており、平衡型出力ドライバを備えています。上限値を超える電流が流れる可能性があるため、バスが競合しないように注意が必要です。また、大きな駆動能力で軽負荷を駆動することでも高速なエッジが生じるため、配線と負荷の条件を検討してリンギングを防止してください。

8.2.2 詳細な設計手順

- 推奨入力条件
 - 立ち上がり時間と立ち下がり時間の仕様については、[セクション 5.3](#) の表の $\Delta t/\Delta V$ を参照してください。
 - 規定された High および Low レベルについては、[セクション 5.3](#) の表の V_{IH} および V_{IL} を参照してください。
 - 入力は過電圧許容で、任意の有効な V_{CC} において最大 5.5 V に対応できます。
- 推奨出力条件
 - 負荷電流は、出力あたりの 35 mA および部品の合計 70 mA を超えないようにする必要があります。
 - 出力は、 V_{CC} を超えてプルされないようにしてください。

8.2.3 アプリケーション曲線

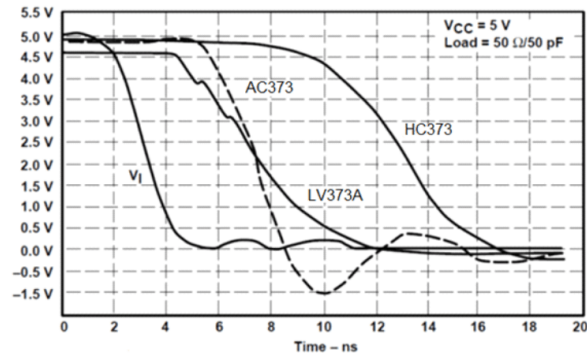


図 8-2. スイッチング特性の比較

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「[セクション 5.3](#)」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。

電源の障害を防止するため、各 V_{CC} ピンに適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単一電源のデバイスの場合は、 $0.1\mu\text{F}$ のコンデンサを推奨します。複数の V_{CC} ピンがある場合は、各電源ピンに対して $0.01\mu\text{F}$ または $0.022\mu\text{F}$ のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。 $0.1\mu\text{F}$ と $1\mu\text{F}$ のコンデンサを並列に使用するのが一般的です。最良の結果を得るため、バイパス コンデンサは電源ピンのできるだけ近くに配置してください。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

多ビット ロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングにしないでください。多くの場合、デジタル ロジック デバイスの機能または機能の一部は使用されません。例えば、トリプル入力 AND ゲートの 2 入力のみを使用する場合や、4 バッファ ゲートのうち 3 入力のみを使用する場合です。このような入力ピンを未接続のままにしないでください。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。

[レイアウト図](#)に示された仕様は、あらゆる状況で遵守する必要があります。デジタル ロジック デバイスの未使用の入力はすべて、フローティングにならないように、High または Low バイアスに接続する必要があります。特定の未使用の入力に対して適用が必要となるロジック レベルは、デバイスの機能により異なります。一般に、GND または V_{CC} のうち、より適切であるかより利便性の高い方に接続されます。本部品がトランシーバでない限り、出力をフローティングにすることが許容されます。トランシーバに出力イネーブル ピンがある場合、アサートされると本部品の出力セクションがディセーブルになります。これによって I/O の入力セクションはディセーブルされないため、ディセーブル時にもフローティングにできません。

8.4.2 レイアウト例

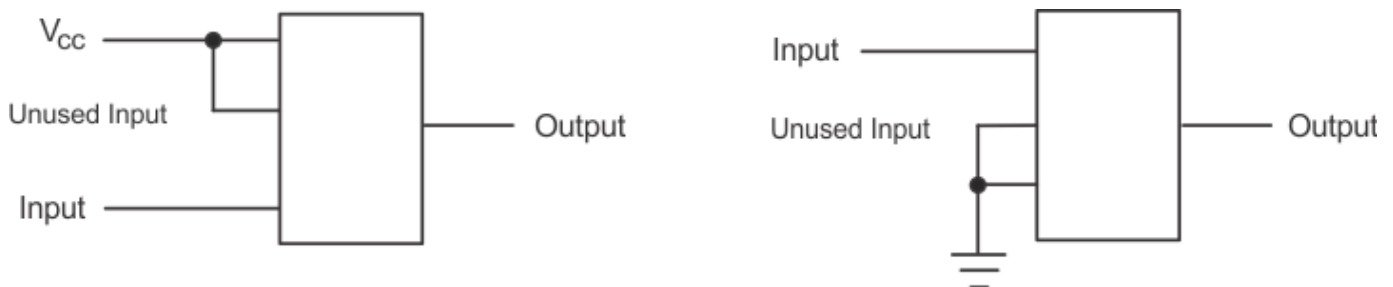


図 8-3. レイアウトの例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

次の表に、クイック アクセス リンクを示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティリソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック アクセスが含まれます。

表 9-1. 関連リンク

製品	プロダクトフォルダ	サンプルとご購入	技術資料	ツールとソフトウェア	サポートとコミュニティ
SN54AC14	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック
SN74AC14	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision H (January 2023) to Revision I (July 2024)	Page
• パッケージ情報の表、「ピン構成および機能」セクション、熱に関する情報の表に BQA パッケージ サイズを追加.....	1
• 「製品情報」の表にパッケージ サイズを追加.....	1
• RθJA の値を更新:D = 86~89.9、DB = 96~101.2、N = 80~72.1、NS = 76~92.4、PW = 113~148、値はすべて°C/W 単位.....	5

Changes from Revision G (August 2008) to Revision H (January 2023)

Page

- 「アプリケーション」セクション、「製品情報」表、「ピンの機能」表、「ESD 定格」表、「熱に関する情報」表、「代表的特性」セクション、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加..... **1**

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
5962-87624012A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87624012A SNJ54AC 14FK	Samples
5962-8762401CA	ACTIVE	CDIP	J	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8762401CA SNJ54AC14J	Samples
5962-8762401DA	ACTIVE	CFP	W	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8762401DA SNJ54AC14W	Samples
5962-8762401VCA	ACTIVE	CDIP	J	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8762401VC A SNV54AC14J	Samples
5962-8762401VDA	ACTIVE	CFP	W	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8762401VD A SNV54AC14W	Samples
5962-8762402VCA	ACTIVE	CDIP	J	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8762402VC A SNV54AC14J	Samples
5962-8762402VDA	ACTIVE	CFP	W	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8762402VD A SNV54AC14W	Samples
SN74AC14BQAR	ACTIVE	WQFN	BQA	14	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AC14	Samples
SN74AC14D	OBSOLETE	SOIC	D	14		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	AC14	
SN74AC14DBR	ACTIVE	SSOP	DB	14	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AC14	Samples
SN74AC14DR	ACTIVE	SOIC	D	14	2500	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AC14	Samples
SN74AC14N	ACTIVE	PDIP	N	14	25	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-40 to 85	SN74AC14N	Samples
SN74AC14NSR	ACTIVE	SOP	NS	14	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AC14	Samples
SN74AC14NSRG4	ACTIVE	SOP	NS	14	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AC14	Samples
SN74AC14PW	OBSOLETE	TSSOP	PW	14		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	AC14	
SN74AC14PWR	ACTIVE	TSSOP	PW	14	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AC14	Samples

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74AC14PWRG4	ACTIVE	TSSOP	PW	14	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AC14	Samples
SNJ54AC14FK	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87624012A SNJ54AC14FK	Samples
SNJ54AC14J	ACTIVE	CDIP	J	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8762401CA SNJ54AC14J	Samples
SNJ54AC14W	ACTIVE	CFP	W	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8762401DA SNJ54AC14W	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSELETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and

continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN54AC14, SN54AC14-SP, SN74AC14 :

- Catalog : [SN74AC14](#), [SN54AC14](#)
- Automotive : [SN74AC14-Q1](#), [SN74AC14-Q1](#)
- Military : [SN54AC14](#)
- Space : [SN54AC14-SP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Military - QML certified for Military and Defense Applications
- Space - Radiation tolerant, ceramic packaging and qualified for use in Space-based application

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74AC14BQAR	WQFN	BQA	14	3000	180.0	12.4	2.8	3.3	1.1	4.0	12.0	Q1
SN74AC14DBR	SSOP	DB	14	2000	330.0	16.4	8.35	6.6	2.4	12.0	16.0	Q1
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	3.75	3.75	1.15	8.0	12.0	Q1
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74AC14NSR	SOP	NS	14	2000	330.0	16.4	8.2	10.5	2.5	12.0	16.0	Q1
SN74AC14NSR	SOP	NS	14	2000	330.0	16.4	8.45	10.55	2.5	12.0	16.2	Q1
SN74AC14PWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AC14PWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AC14PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AC14PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74AC14BQAR	WQFN	BQA	14	3000	210.0	185.0	35.0
SN74AC14DBR	SSOP	DB	14	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	32.0
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
SN74AC14DR	SOIC	D	14	2500	356.0	356.0	35.0
SN74AC14NSR	SOP	NS	14	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AC14NSR	SOP	NS	14	2000	353.0	353.0	32.0
SN74AC14PWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
SN74AC14PWR	TSSOP	PW	14	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AC14PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AC14PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0

TUBE


*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
5962-87624012A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
5962-8762401DA	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
5962-8762401VDA	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
5962-8762402VDA	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
SN74AC14N	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
SN74AC14N	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
SNJ54AC14FK	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
SNJ54AC14W	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA



D0014A

PACKAGE OUTLINE

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4220718/A 09/2016

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

BQA 14

WQFN - 0.8 mm max height

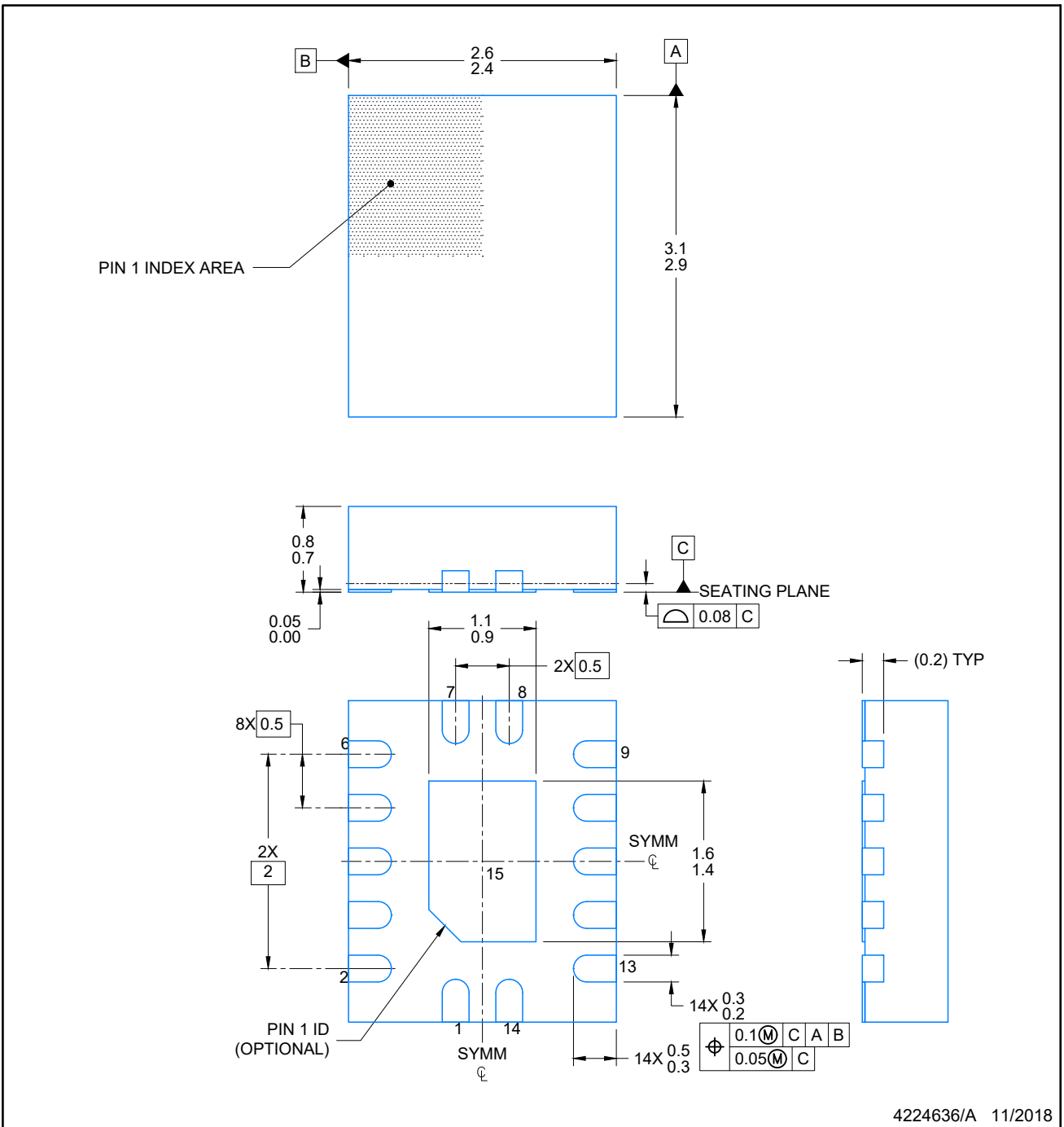
2.5 x 3, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4227145/A



NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

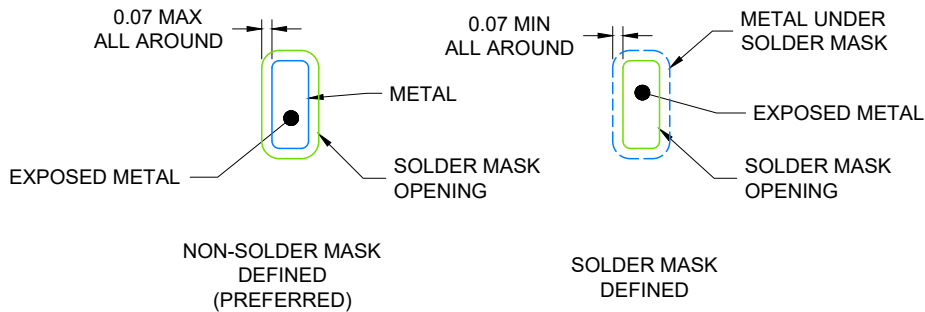
WQFN - 0.8 mm max height

BQA0014A

PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



4224636/A 11/2018

NOTES: (continued)

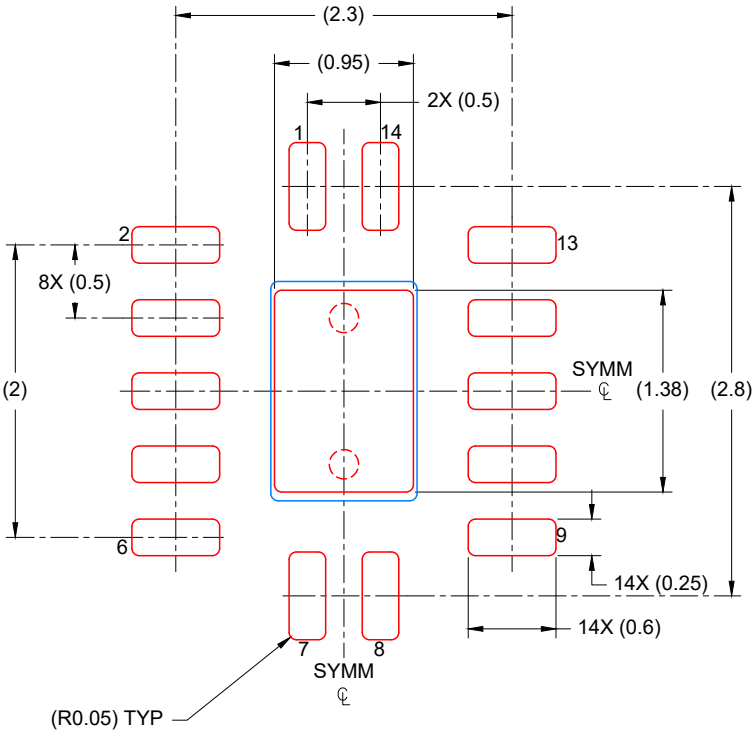
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

BQA0014A

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
 88% PRINTED COVERAGE BY AREA
 SCALE: 20X

4224636/A 11/2018

NOTES: (continued)

- 6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

MECHANICAL DATA

NS (R-PDSO-G**)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

14-PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

W (R-GDFP-F14)

CERAMIC DUAL FLATPACK



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. This package can be hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
 - D. Index point is provided on cap for terminal identification only.
 - E. Falls within MIL STD 1835 GDFP1-F14

DB0014A



PACKAGE OUTLINE

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-150.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DB0014A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220762/A 05/2024

NOTES: (continued)

- 5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0014A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220762/A 05/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

FK 20

LCCC - 2.03 mm max height

8.89 x 8.89, 1.27 mm pitch

LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4229370VA\

J 14

GENERIC PACKAGE VIEW
CDIP - 5.08 mm max height
CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4040083-5/G

J0014A



PACKAGE OUTLINE

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



4214771/A 05/2017

NOTES:

1. All controlling linear dimensions are in inches. Dimensions in brackets are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
4. Index point is provided on cap for terminal identification only and on press ceramic glass frit seal only.
5. Falls within MIL-STD-1835 and GDIP1-T14.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

J0014A

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 5X



4214771/A 05/2017

N (R-PDIP-T**)

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 - The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.



4220202/B 12/2023

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated